

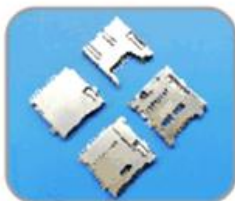


SIM防溃PIN设计优劣势分析简易报告

报告编号: XNT-PZ-19-04-03

朱九连

2019年4月3日



TF全系列



HDMI全系列



SIM全系列



USB全系列



RJ/VGA系列



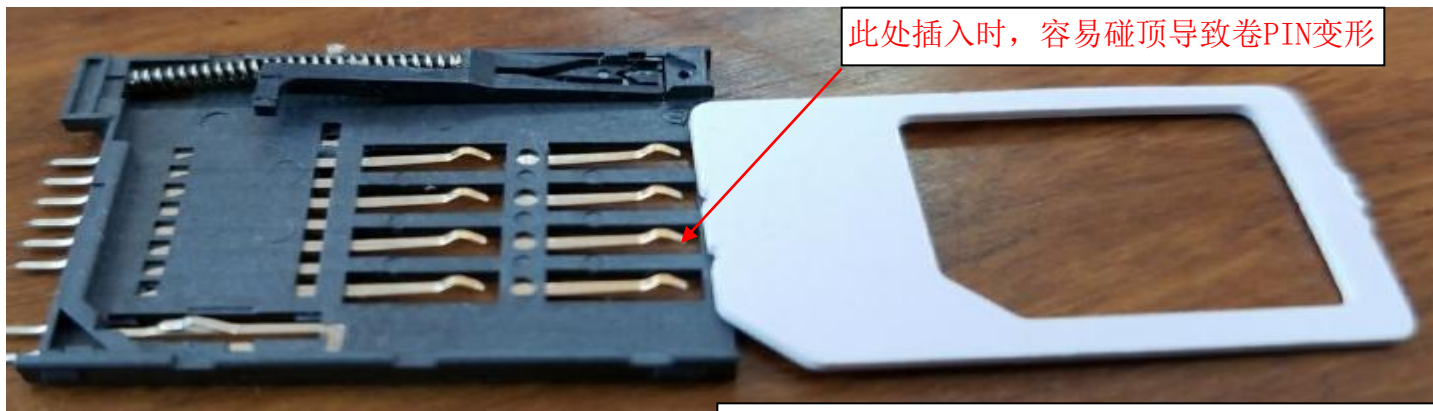
耳机/DC系列



1.问题描述:

以往市场上众多SIM卡座弹片设计一般在电话卡插入时与退卡时存在碰到弹片，导致弹片变形卷PIN等不良现象发生，一般旧结构分为以下3种，如下图示

第1种:

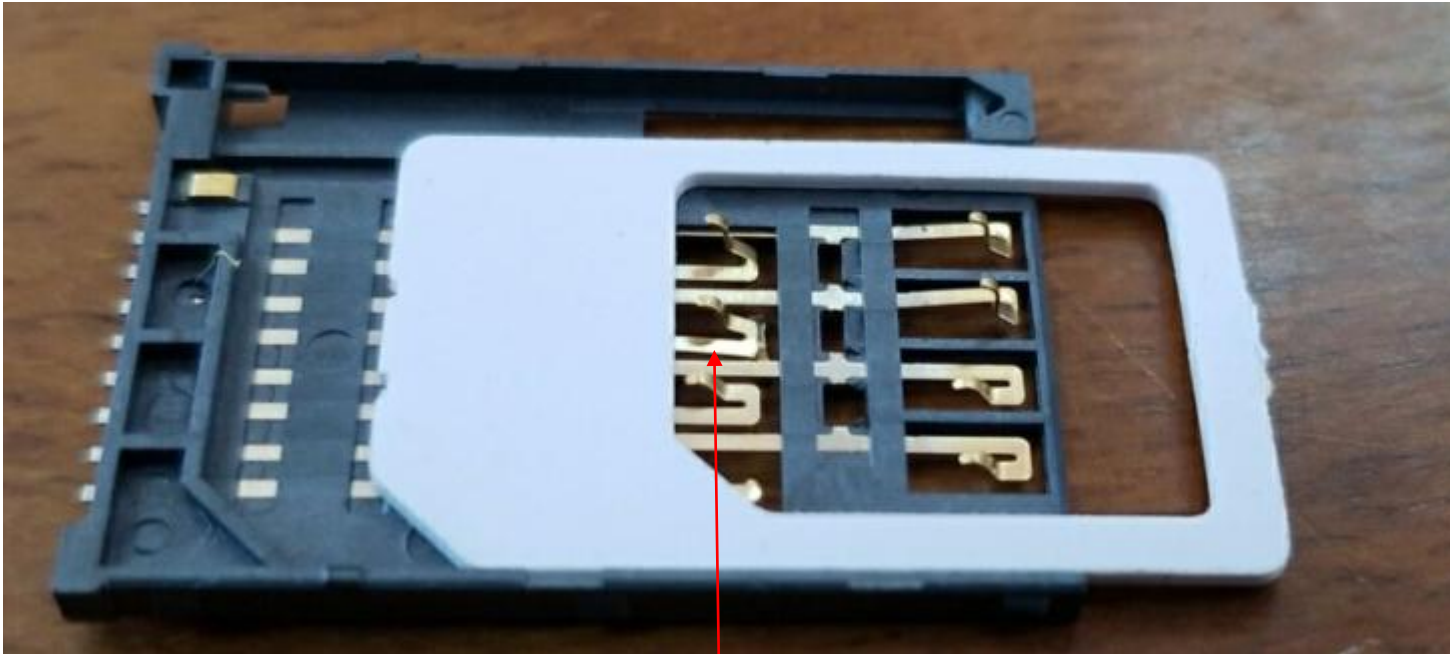


第2种:





第3种:

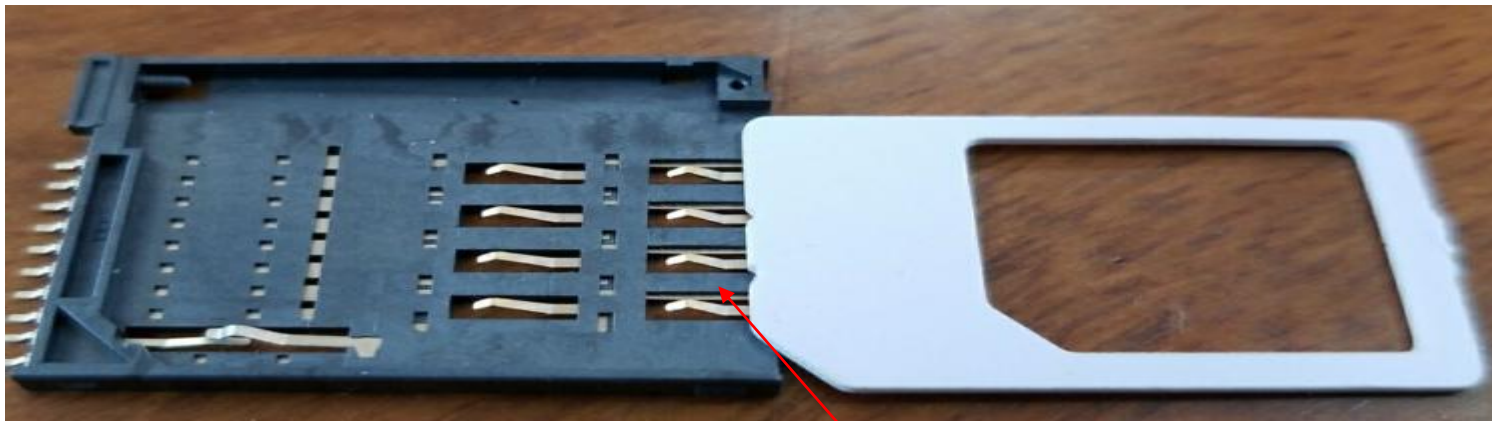


在众多消费人群中，消费类产品难免会有一部份人，奥而将此处电话卡卡套插入时，想要取出时无法取出，强行拔出会导致SIM卡座严重损坏



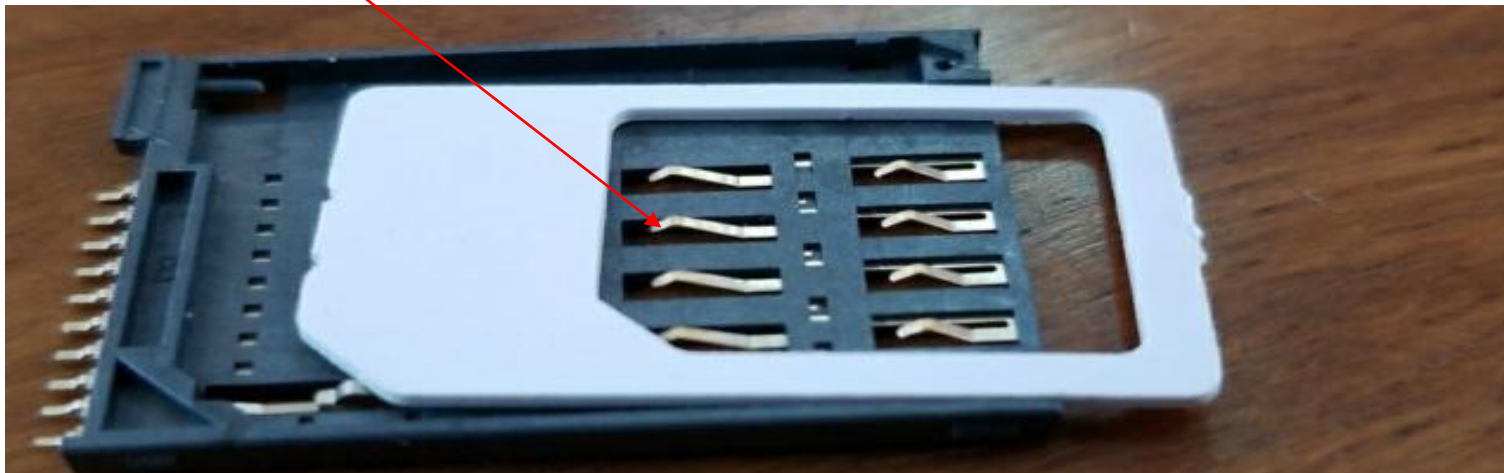


最新优化结构如下:



当电话卡套插入取出时，弹片头部尖尖位置
低於塑胶，拔出时可以很顺畅的拔出来

当电话卡插入时，卡座弹片顺向，无论怎么
插都是不会导致弹片变形等





THE END

